

主な加工品



半導体製造機器の部品の受託加工・研究開発・販売 ★大量生産ではなく、技術力を活かした受託加工を行なっています。

・弊社は令和5年7月に株式会社芝技研から製造、品質保証部門を独立させて分社した会社です。

・半導体製造装置に使われる部品を製造する当社は、技術力の高さに定評があった芝技研の技術を引継ぎ、お客様から直接ご依頼を受けて、受託加工などをメインに事業を展開。もともとの強みである「質」をさらに追及していく会社です。

工場外観



受託加工 小径孔加工

小径孔加工 技術特長

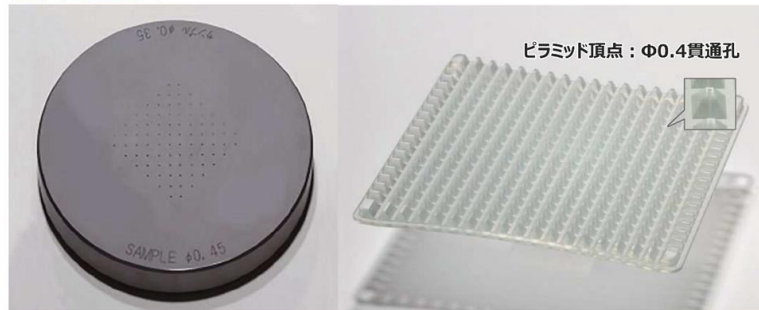
- 1. 高歩留まり
- 2. 0.06mm～極小径孔加工
- 3. ダメージレス加工

小径孔加工 技術例

加工例

孔径Φ0.06×深さ0.6mm (Si) 孔径Φ1.0×深さ50mm (Alumina)
 孔径Φ0.4×深さ30mm (Si) 孔径Φ0.5×深さ13mm (SiC)

Si小径孔加工



小径孔加工 応用例

ドライエッチング用 Si・SiC 部品

- 1
- 6,8,12 インチ用消耗部品
- 2
- OEM 認定工場 (本社工場・台湾工場)

製品概要

材料	単結晶Si外径Φ280～Φ480 × 厚みt10mm～
孔明け加工	500～3000カ所 孔径Φ0.3～Φ0.5貫通孔加工

